

# 목 차

영 업 보 고 서 .....	1
-----------------	---

# 영 업 보 고 서

## 1. 회사의 개황

### (1) 회사의 목적

1. 반도체 장비 제조 판매업
2. LCD/PDP 장비 제조 판매업
3. 레이저 응용장비 제조 판매업
4. 수압절단기계 제조 판매업
5. 수압세척기계 제조 판매업
6. 유압기계 제조 판매업
7. 수압절단 가공 용역업
8. 일반자동화기계 제조 판매업
9. OLED, FPD 장비 개발 및 제조 판매업
10. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매
11. 통신용 부품 개발, 생산 및 판매
12. 전자부품 및 기계장비부품 도,소매업
13. 부동산임대업
14. 위 관련장비 수출입업
15. 위 부대사업 일체

### (2) 공장 및 사업소 현황

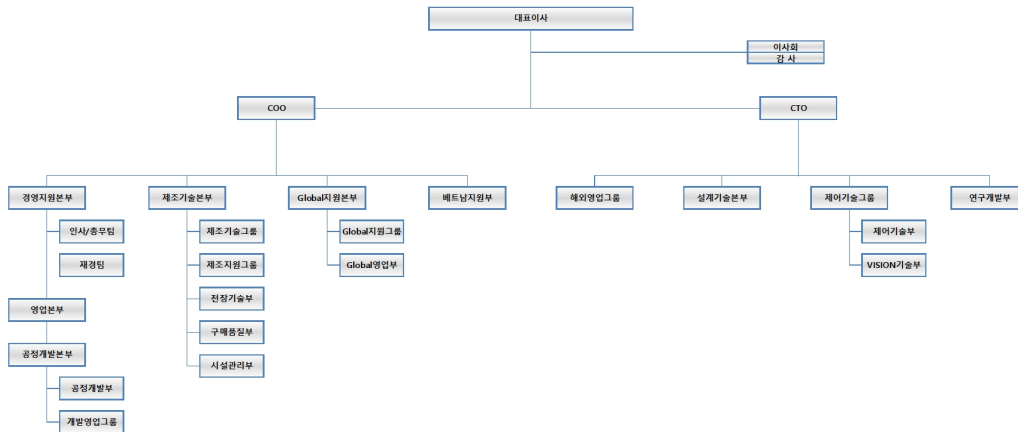
사업장의 명칭	주요사업내용	소재지
본사	디스플레이장비사업 반도체장비사업 레이저응용장비사업 바이오진단키트제조장비사업	충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15
천안 이노베이션 센터	Innovation Center	충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단 5로 117-26
성환사업장	디스플레이장비사업	충청남도 천안시 서북구 성환읍 와룡길16
마곡 R&D센터	R&D 센터	서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 46

### (3) 종업원 현황

(2021년 12월 31일 기준)

구 분	사무직,영업직	기술,연구직	생산직	합계
인원수 (구성비율)	60명 (22.4%)	146명 (54.7%)	61명 (22.9%)	267명 (100.0%)

## < 제이스텍 조직도 >



### (4) 주식에 관한 사항

#### 1) 주식의 종류와 수

(단위 : 주, 원)

발행할 주식의 수	주식의 종류	발행한 주식의 수	납입 자본금
50,000,000	기명식 보통주	14,597,808	7,298,904,000

#### 2) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 천원)

변동일자	주식의종류	변동주식수	변동금액	변동후자본금	변동사유
95.03.09	보통주	100,000주	50,000	50,000	설립자본금
98.04.28	보통주	200,000주	100,000	150,000	유상증자
01.08.21	보통주	900,000주	450,000	600,000	유상증자
02.08.24	보통주	180,000주	90,000	690,000	유상증자
02.08.26	보통주	1,380,000주	690,000	1,380,000	무상증자
07.01.05	보통주	740,000주	370,000	1,750,000	유상증자
07.02.15	보통주	100,000주	50,000	1,800,000	유상증자
10.09.29	보통주	3,600,000주	1,800,000	3,600,000	무상증자
11.01.29	보통주	353,356주	176,678	3,776,678	합병신주
12.04.12	보통주	742,744주	371,372	4,148,050	주식배당
12.12.03	보통주	689,655주	344,828	4,492,878	유상증자 (BW행사)

12.12.11	보통주	394,087주	197,044	4,689,921	유상증자 (BW행사)
12.12.21	보통주	394,087주	197,044	4,886,965	유상증자 (BW행사)
13.04.11	보통주	4,823,879주	2,411,940	7,298,904	무상증자
합 계		14,597,808주	7,298,904		-

### 3) 주식사무

결산일	매년 12월 31일	
정기주주총회 개최	매 사업년도 종료 후 3개월 이내	
주주명부 폐쇄기간	1월 1일부터 1월 15일까지	
공고매체	전자공고	
주식등의 전자등록	회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등 을 전자등록하여야 한다.	
주식업무대행기관	대리인의 명칭	(주)국민은행 증권대행부
	사무취급 장소	서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

### (5) 사채에 관한 사항

(기준일 : 2021년 12월 31일)

(단위 : 원, 주)

종류\구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총 액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채	
							전환비율 (%)	전환가액	권면(전자등록)총 액	전환가능주식 수
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채	1	2021년 07월 23일	2026년 07월 23일	19,000,000,000	보통주	2022년07월23일~2026년06월 23일	100	6,600	19,000,000,000	2,878,787
합 계				19,000,000,000			100	6,600	19,000,000,000	2,878,787

## 2. 영업의 경과 및 성과

### (1) 영업의 개황

#### 1) OLED, LCD 장비

- PCB Bonding장비는 Module 공정에서 Panel 구동 PCB Bonding 시스템으로 Source부 TAB-IC에 ACF를 이용하여 각각의 PCB를 압착하는 인라인 장비입니다.

- OLED 장비는 당사가 기존의 PCB 공정을 확장하여 OLB, 검사 공정까지 개발 완성하여 모듈제조 풀 오토 인라인 시스템을 생산 공급하고 있으며, 수년간의 연구개발을 통해 Flexible 본딩장비를 개발하여 주요 고객사에 제작 공급하고 있습니다.

- OLED 시장은 시장의 규모가 기하급수적으로 증가하는 초기 시장으로 당사가 개발 단계에서부터 시장을 선점하고 있어 OLED 시장의 확대와 함께 큰 폭의 성장이 기대되고 있습니다.

## 2) Laser 응용장비

- 당사는 Laser를 이용하여 평판 Panel 디스플레이 본딩 관련 양산장비를 개발하였으며 터치스크린패널본딩장비, RFID 태그 본딩장비를 생산 공급하고 있습니다. 이는 디스플레이 기판의 열적 손상 방지 등을 위한 본딩 공법으로 차세대 프로세스로 주목받고 있습니다.
- 레이저 정밀가공 시장은 산업의 추세가 고기능 및 경박, 단소화됨에 따라 레이저를 이용한 정밀 미세 가공 공법으로 진행되고 있습니다.
- 이에 당사는 레이저를 이용하여 초정밀/초고속으로 Cutting, Patterning, Drilling 할 수 있는 복합 가공 기술을 개발하였으며, 최근 디스플레이 추세인 Narrow Bezel 방식이 적용되도록 레이저를 이용한 편광필름(POL) Cutting 장비를 개발 공급하였습니다.
- 또한 당사는 스캐너-스테이지 연동 기술(Motion On The Fly)을 기반으로 한 레이저 기반 대면적 가공 기술을 활용 초정밀 가공과 초고속 가공, 대면적 연속가공이 가능한 기술을 구현하여 향후 매출 신장 및 수익성 향상을 기대하고 있습니다.

## 3) 워터젯 세정 도금 장비

- 당사는 다이아몬드 노즐을 이용한 워터젯(Ultra High Pressure Water Jet Technology by Diamond Fan-Tip Nozzles) 이라는 독보적 기술을 원천기술로 하여 반도체 리드프레임 세정장비를 생산하고 있습니다.
- 전해 도금장비는 트랜지스터나 IC칩 등 스트립 형태의 반도체를 당사 독자 특허 기술인 무한궤도 이송용 벨트로 장착 이송하면서 반도체 부품의 리드프레임을 전기도금하는 장비입니다.
- 당사의 반도체 후공정 장비(디플래시장비, 도금장비)는 독자적인 원천기술, 특허기술, 자동화기술을 기반으로 하고 있으며, 새로운 시장개척,제품 다변화를 추진하고 있습니다.

## (2) 주요 제품별 판매 실적

(단위: 백만원)

구 분	2021년(제27기)		2020년(제26기)	
	금 액	비 율	금 액	비 율
디스플레이	43,290	53%	85,801	75%
레이저응용	5,699	7%	15,629	14%
워터젯세정도금	10,073	12%	1,159	1%
바이오진단키드	12,723	16%	-	0%
기타 유닛 및 부품	10,052	12%	11,859	10%
매출액	81,838	100%	114,449	100%
영업이익	(1,484)	-	(10,268)	-

- 당사는 2021년 818억원의 매출액과 15억원의 영업손실을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 326억원 감소(증가율 -28%)하였고, 영업이익은 88억원 증가(증가율 86%)하였습니다.
- 장비별로 보면, 디스플레이장비가 433억원으로 전체 매출액의 53%를 차지하고 있고, 레

이저응용장비가 57억원(매출비중 7%), 워터젯세정도금장비가 101억원(매출비중 12%), 바이오진단키트장비가 127억원(매출비중 16%), 기타 유닛 및 부품매출이 100억원(매출비중 12%)입니다.

- 당사는 국내 대기업 고객사에 디스플레이 제조장비를 제작/매출한 경험을 바탕으로 적극적으로 경쟁하여 시장주도권을 확보할 수 있도록 노력할 것입니다.
- 당사의 강점인 선행기술개발에도 중점을 두어 진행하고 있습니다. 기술개발은 고객사 장비의 업그레이드로 이어지며, 우리나라 디스플레이 제품의 세계경쟁력에도 우위를 가지게 합니다. 더불어 당사의 지속가능한 성장을 뒷받침 할 수 있는 힘이기도 합니다.
- 당사는 치열한 영업환경을 극복하기 위해 신규시장 확대와 원가절감, 새로운 성장 동력 확보 및 고객밀착경영 등을 통하여 지속적으로 성장 발전하도록 노력하겠습니다.

### (3) 주요 투자내용과 자금조달현황

(단위: 백만원)

주요투자내용	투자금액	자금조달현황			비 고
		타인자본	자기자금	기타자금	
토지	904	-	904	-	
건물, 구축물	7,178	-	7,178	-	
기계장치	21	-	21	-	
차량운반구	-	-	-	-	
공구기구?비품	202	-	202	-	
시설장치	141	-	141	-	
시험연구용자산	-	-	-	-	
기타유형자산	64	-	64	-	
산업재산권	17	-	17	-	
S/W	328	-	328	-	
개발비	-	-	-	-	
회원권	47	-	47	-	
건설중인자산	639	-	639	-	
합 계	9,541	-	9,541	-	

### 3. 최근3년간 영업실적 및 재산상태

#### (1) 영업실적

(단위: 백만원)

과 목	제27기	제26기	제25기	비고
	2021.01.01~12.31	2020.01.01~12.31	2019.01.01~12.31	
I. 매출액	81,838	114,449	126,893	주1)
II. 매출원가	69,015	108,660	109,312	
III. 매출총이익	12,823	5,789	17,581	
IV. 판매비와관리비	14,308	16,057	17,182	

V. 영업이익(손실)	(1,484)	(10,268)	399
기타수익	10,223	708	711
기타비용	3,581	2,154	1,036
금융수익	4,170	2,596	2,536
금융비용	2,507	9,183	1,699
VI. 법인세비용차감전순이익	6,820	(18,300)	911
법인세비용	1,469	(3,727)	(143)
VII. 당기순이익	5,351	(14,574)	1,055
지배기업 귀속 순이익(손실)	6,117	(14,212)	1,566
비지배지분 귀속 순이익(손실)	(766)	(362)	(511)
VIII. 기타포괄손익	41	(31)	(14)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	(6)	(20)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	41	(25)	7
IX. 총포괄이익	5,392	(14,605)	1,041
지배기업 귀속 총포괄이익	6,157	(14,237)	1,562
비지배지분 귀속 총포괄이익	(766)	(367)	(521)
X. 주당손익			
기본주당기순이익	423원	(982)원	108원
희석주당기순이익	392원	(982)원	108원

주1) 당사는 2011회계연도(제17기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 상기 영업실적은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 재산상태

(단위: 백만원)

과 목	제27기	제26기	제25기	비고
	2021년말	2020년말	2019년말	
유동자산	70,780	53,613	61,814	주1)
비유동자산	89,751	93,062	90,971	
- 자산총계	160,531	146,674	152,785	
유동부채	21,418	31,030	22,993	
비유동부채	17,031	1,084	223	
- 부채총계	38,449	32,115	23,216	
자본금	7,299	7,299	7,299	
자본잉여금	6,545	4,161	4,161	
기타자본	(893)	(893)	(893)	
기타포괄손익누계	24	(16)	9	
이익잉여금	109,919	104,526	119,403	
비지배지분	(811)	(517)	(410)	

- 자본총계	122,082	114,559	129,569
--------	---------	---------	---------

주1) 당사는 2011회계연도(제17기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 상기 영업실적은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

4. 회사가 대처할 과제  
- '영업의 개황' 참조

5. 이사 및 감사 현황

직명 (상근/등기 여부)	성명 (생년월일)	담당업무	회사와의 거래관계	비고
대표이사 (상근/등기)	정재송 (1958.5.16)	경영총괄	없음	-
대표이사 (상근/등기)	최기열 (1962.6.2)	CTO	없음	-
대표이사 (상근/등기)	김두열 (1958.2.28)	COO	없음	-
사외이사 (비상근/등기)	남시환 (1959.11.10)	사외이사	없음	-
감사 (상근/등기)	박철환 (1958.10.06)	감사	없음	-

6. 주요주주, 관계기업, 채권자 및 기타 중요사항

(1) 최대주주 현황

(2021.12.31 현재, 단위: 주, %)				
주주명	소유주식수	지분율	회사와의 거래관계	비고
정재송	5,566,322	38.13%	-	최대주주 및 특수관계인
최기열	892,320	6.11%	-	
자사주	126,393	0.87%	-	-

(2) 주식 현황

(2021.12.31 현재)				
구분	주주수		주식수	
	인원(명)	비율(%)	주식수(주)	비율(%)
소액주주합계	7,432	99.96	7,574,873	51.89
소액주주(법인)	45	0.61	524,925	3.6
소액주주(비법인)	7,387	99.35	7,049,948	48.29
1%이상 합계	3	0.04	7,022,935	48.11



1%이상(법인)	1	0.01	564,293	3.87
1%이상(비법인)	2	0.03	6,458,642	44.24
합 계	7,435	100	14,597,808	100

(3) 종속회사 현황 및 요약 재무정보

종속회사	소재지	지분율	결산월	업종
JASTECH VIET NAM	베트남	100%	12월	디스플레이 셋업 용역제공
브이오	한국	50.00%	12월	FPD 검사 장비 솔루션 개발
제이와이글로벌이노베이터	한국	100%	12월	신기술금융

(단위 : 백만원)					
종속회사	자산	부채	매출	당기손익	포괄손익
JASTECH VIET NAM	817	378	1,240	24	65
브이오	19	1,648	361	(1,537)	(1,537)
제이와이글로벌이노베이터	9,947	-	-	(53)	(53)

(4) 관계기업 투자주식

- 해당사항 없음

(5) 주요 채권자

- 해당사항 없음

(6) 결산기 후에 생긴 중요한 사항

- 특기사항 없음

(7) 기타 영업에 관한 중요한 사항

- 특기사항 없음